

证券代码：603773

证券简称：沃格光电

江西沃格光电集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<div><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/>媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/>现场参观</div> <div><input type="checkbox"/>其他</div> <div><input type="checkbox"/>分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/>路演活动</div> <div><input type="checkbox"/>电话会议</div>
活动参与机构名称	国泰海通证券、易方达基金、达成财智、蓝海基金、格隆汇、宏惟创世、聚众鑫创投、杰灵达实业、怀新投资、长城证券、德远投资、民沣私募、亚太汇金、必达控股、睿智基金
公司接待人员	董事会秘书龚庆宇
时间	2025 年 12 月 29 日至 2025 年 12 月 31 日
地点	沃格光电深圳分公司
交流内容及具体问答记录	<div>一、公司业务介绍</div> <p>江西沃格光电集团股份有限公司是国家高新技术企业，正从传统显示玻璃精加工向“玻璃基+”高端制造全面升级，聚焦显示、通信与半导体三大领域，公司是全球最早实现玻璃电路板（GCP）产业化的企业。</p> <p>公司主营业务主要包括三大块。第一是沃格光电公司及子公司为经营主体的传统业务，包括显示面板相关玻璃精加工和显示器件产品业务；第二是以江西德虹显示为经营主体的新型显示业务，包括玻璃基 Mini LED 背光新型显示模组、Micro LED 直显玻璃基板两大类。第三是以湖北通格微为经营主体的玻璃基线路板和玻璃器件产品在泛</p>

	<p>半导体行业的应用，包括 5G-A\6G、卫星通信玻璃基 RF 射频器件、光通讯领域光模块/CP0、半导体先进封装领域玻璃基 Chiplet 先进封装载板及其封装技术开发和应用。目前，公司主营业务以第一块业务贡献为主，第二块和第三块业务取得较好进展和应用突破。</p> <p>此外，公司积极参与玻璃基微流控生物芯片的开发，航天卫星太阳翼材料的开发及加工、半导体刻蚀设备和光刻机用玻璃器件及加工工艺开发等领域。</p> <p>2025 年 1 - 9 月，公司实现营收 19 亿元，同比增长 15.66%；研发费用 1.26 亿元，同比增长 50.90%；公司传统业务业绩保持盈利并稳健增长，由于持续加大在玻璃电路板等新产品新技术的研发投入，以及新产线投产带来折旧等固定成本的上升，导致归母净利润为-6,694 万元，但经营性现金流仍达 1.26 亿元，主业造血能力稳健。公司拥有授权专利超 500 项（其中发明专利 135 项），技术壁垒持续强化。</p> <p>二、问答环节</p> <p>1. 成都沃格 8 代 AMOLED 玻璃基板精加工项目的最新进展？预计何时量产？</p> <p>回复：公司全资子公司成都沃格显示技术有限公司运用自主开发的 ECI 一体化技术（玻璃薄化、丝印、切割），为国内首条 8 代 AMOLED 产线提供玻璃基精加工配套服务。该技术历经 4 年联合研发，公司是目前国内唯一掌握 ECI 技术的企业。项目正处于设备搬入阶段，预计 2026 年实现量产，满产后月产能可达 2.4 万片。该项目将推动公司 ECI 技术在大尺寸 AMOLED 领域的首次产业化，巩固公司在玻璃精加工技术的领先地位，并为后续拓展国内外先进面板厂 8 代 AMOLED 市场奠定基础，有望成为公司新的盈利增长点。</p> <p>2. 公司传统业务板块当前运营状况和盈利情况如何？</p> <p>回复：公司传统业务涵盖显示面板玻璃精加工与显示器件产品，是目前收入与利润的主要来源。自 2018 年上市以来，该板块保持稳</p>
--	---

健增长，2019-2024 年营收复合增长率超 30%，2025 年受益于国内 8 代 IT 产线产能释放，玻璃精加工业务满负荷运转，通过产品结构优化提升了盈利能力。

公司整体业绩短期承压主要源于两大投入：一是玻璃电路板（GCP）新技术、新产品的研发支出持续加大，包括核心人才引进与研发费用的显著增长；二是江西德虹玻璃基 Mini/Micro LED 产线与湖北通格微 TGV 先进封装产线建成投产，新增固定资产折旧成本。随着技术突破、客户导入完成及订单逐步落地，经营表现将开始改善。

3. 江西德虹玻璃基 MiniLED 背光业务的行业前景与客户拓展情况如何？

回复：MiniLED 背光市场正处于高速成长期，据 Omdia 预测，2025 年全球 MiniLED 电视销量将突破 1300 万台，同比实现翻倍增长，已成为主流电视品牌中高端机型的标配，并呈现分区数增加、性能要求提升的趋势。玻璃基板凭借高平整度、低热膨胀系数等优势，在高密度 LED 芯片应用场景下兼具性能与成本竞争力。

江西德虹已建成一期年产能 100 万平米玻璃基 MiniLED 基板产线，经工艺优化，产品良率达到行业优秀水平。今年已在海信大圣 G9 电竞显示器上实现量产应用，同时与十余家国内外知名品牌客户开展 TV、显示器、娱乐机、车载等领域的联合开发。在 MicroLED 直显领域，公司亦配合国内外多家显示客户在开展玻璃基直显产品开发，并取得阶段性进展。预计江西德虹 2026 年起订单逐步放量将带动该业务板块业绩改善。

4. 公司在玻璃基封装领域的技术储备、产业化进度及竞争地位如何？

回复：公司在玻璃基封装领域拥有显著先发优势与技术壁垒，是全球少数掌握“薄化、镀膜、黄光、TGV、精密镀铜、多层线路制作”全制程工艺并实现量产的企业。核心技术指标方面，TGV 工艺可实现最大深宽比 100:1、最小孔径 5 μm、加工厚度 0.05-1.1mm，均处

	<p>于行业领先水平。</p> <p>公司已建成首条年产 10 万平米 TGV 产线，产品在 Micro LED、5G-A/6G 射频器件、光模块/CP0、算力芯片先进封装、微流控生物芯片等多领域同步推进，与国内外多家头部企业建立战略合作。近期公司牵头发起中国玻璃线路板产业联盟，推动 GCP 技术创新与产业链协同。光模块 CP0 玻璃基产品已于下半年批量送样，微流控生物芯片即将进入量产阶段。</p> <p>5. 玻璃基板材料在显示、通信、半导体等领域应用的核心优势是什么？</p> <p>回复：玻璃基板在多个高科技领域受到青睐，主要因其相较于传统有机基板和硅基板具备综合性能优势：</p> <ul style="list-style-type: none">1) 热稳定性强：热膨胀系数与硅芯片接近，高温环境下翘曲风险低，封装可靠性高；2) 介电性能优异：作为天然绝缘体，介电常数与损耗因子远低于硅材料，在 5G、AI 芯片等高频高速场景下可降低信号传输损耗与延迟，保障信号完整性；3) 表面精度高：极平整的表面为高精度光刻与超高密度布线提供理想基础；4) 互联密度大：通过 TGV 技术实现高密度通孔互连，承载功率与数据连接能力远超传统基板，是延续摩尔定律的有效路径；5) 规模化成本潜力：大尺寸超薄玻璃供应成熟，部分工艺流程简化，大规模生产时具备成本优势。 <p>6. 如何看待柔性太阳翼的发展趋势，公司在卫星柔性太阳翼领域的产品优势及市场进展如何？</p> <p>回复：公司基于在玻璃基线路板转型过程中自主研发的 CPI（无色聚酰亚胺）核心技术，配合头部商业航天客户提供 CPI 膜材及防护镀膜产品，今年已实现柔性太阳翼基材的在轨应用，并正与其他客户推进送样测试。</p> <p>公司在 CPI 膜材领域拥有深厚的技术储备，相关技术为自主研</p>
--	---

发，具备自主知识产权，同时，镀膜技术一直为公司的核心优势，公司已形成 CPI 浆料 - 制膜 - 镀膜的全产业链生产能力，技术水平处于行业领先地位。

CPI 具备超薄、轻质、柔韧性强的物理特性，能承受发射阶段剧烈的折叠与太空中的反复展收，在分子结构层面具备极高的稳定性，确保其在极端条件下依然能保持尺寸稳定与力学性能，CPI 高穿透率有效保障太阳翼的发电效率。特种镀膜通过精准控制膜层的厚度与成分，一方面优化对太阳光特定波段的吸收与反射，提升太阳翼的光电转换效率，另一方面能有效抵御太空中的各种高能粒子辐射和微小碎屑的撞击，抵御强烈的紫外辐射以及原子氧的侵蚀，保护太阳能电池片，从而大幅延长整个太阳翼的工作寿命。

公司看好商业航天柔性太阳翼发展趋势以及太空算力建设对于太阳翼能源供应的需求，随着卫星发射数量的提升以及单颗卫星太阳翼面积的增长，对于太阳翼柔性基材及防护镀膜的需求将高速增长，公司将继续加大柔性太阳翼产品的业务拓展。

7. 公司目前定增进展如何？定增价格如何确定？

回复：公司向特定对象发行股票项目正在有序推进，相关反馈回复已提交上海证券交易所审核。本次定增定价将严格遵循《上市公司证券发行注册管理办法》，通过向符合条件的特定投资者市场询价方式确定，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 80%。最终发行价格由市场竞价形成，受宏观环境、资本市场情绪、投资者认购意愿等多重因素影响。公司将依法合规推进定增工作，及时履行信息披露义务。

8. 公司未来 3 年的战略发展目标是什么？哪些业务将成为主要增长引擎？

回复：沃格光电以显示玻璃精加工业务起家，目前市占率行业领先，多年技术积累沉淀出两大核心能力：玻璃精密加工与功能性镀膜/镀铜。当前产业布局均基于这两大能力延伸，重点发展玻璃线路板

	<p>（GCP）及其在先进封装、新型显示、高频通信领域的应用，同时拓展 CPI 柔性材料等新兴方向，实现技术平台的跨领域赋能。</p> <p>展望未来，随着成都沃格 8 代 AMOLED 精加工项目达产、江西德虹 MiniLED 背光产品放量、湖北通格微 TGV 先进封装规模化应用、柔性太阳翼产品批量订单销售，公司第二、第三块业务占比将显著提升。多项业务共同驱动公司盈利能力的长期持续增长。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无
活动过程中所使用的演示文稿、文档等附件（如有）	无